

<<半导体制造技术>>

图书基本信息

书名：<<半导体制造技术>>

13位ISBN编号：9787505394933

10位ISBN编号：7505394932

出版时间：2004-1

出版时间：电子工业出版社

作者：Michael Quirk,Julian Serda

页数：600

字数：986000

译者：韩郑生

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<半导体制造技术>>

内容概要

在半导体领域，技术的变化遵循着摩尔定律的快速节奏，是以月而不是以年为单位计的。本书详细追述了半导体发展的历史并吸收了当今最新技术资料，学术界和工业界都称赞这是一本目前在市场上能得到的最全面、最先进的教材。

全书共分20章，章节根据应用于半导体制造的主要技术分类来安排，内容包括：与半导体制作相关的基础技术信息；总体流程图的工艺模型概况，用流程图将硅片制造的主要领域连接起来；具本讲解每一个主要工艺；集成电路装配和封装的后部工艺概况。

此外，各章为读者提供了关于质量测量和故障排除的问题，这些都是会在硅片制造中遇到的实际问题。

本书适合作为高等院校微电子技术专业的教材，也可作为从事半导体制造与研究人员的参考书及公司培训员工的标准教材。

<<半导体制造技术>>

书籍目录

第1章 半导体产业介绍第2章 半导体材料特性第3章 器件技术第4章 硅和硅片制备第5章 半导体制造中的化学品第6章 硅片制造中的沾污控制第7章 测量学和缺陷检查第8章 工艺腔内的气体控制第9章 集成电路制造工艺概况第10章 氧化第11章 淀积第12章 金属化第13章 光刻：气相成底膜到软烘第14章 光刻：对准和曝光第15章 光刻：光刻胶显影和先进的光刻技术第16章 刻蚀第17章 离子注入第18章 化学机械平坦化第19章 硅片测试第20章 装配与封装附录A 化学品及安全性附录B 净化间的沾污控制附录C 单位附录D 作为氧化层厚度函数的颜色附录E 光刻胶化学的概要附录F 刻蚀化学术语表

<<半导体制造技术>>

媒体关注与评论

本书追述了半导体集成电路的发展历史，详细描述了集成电路制造的全过程，即硅片制备、硅片制造、硅片测试/拣选、装配和封装以及终测。

具有大量精美的图片、图表及具体详实的数据。

对立志从事微电子技术工作，而又未能实际体验集成电路制造过程的人来说，它无疑是一位良师益友。

即使是正在从事集成电路制造的工程技术人员，也一定会认为它是非常具有价值的参考书。

<<半导体制造技术>>

编辑推荐

本书追述了半导体集成电路的发展历史，详细描述了集成电路制造的全过程，即硅片制备、硅片制造、硅片测试/拣选、装配和封装以及终测。

具有大量精美的图片、图表及具体详实的数据。

对立志从事微电子技术工作，而又未能实际体验集成电路制造过程的人来说，它无疑是一位良师益友。

即使是正在从事集成电路制造的工程技术人员，也一定会认为它是非常具有价值的参考书。

<<半导体制造技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>